

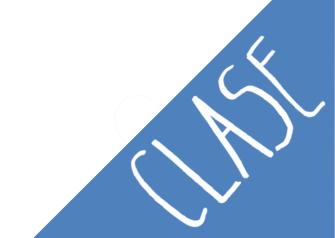
Formación Profesional Oficial a Distancia



ASIX – M05 – Clase 02

Tema 1b Arquitectura de ordenadores

Jorge Pastor López Profesor del Área de Informática y Comunicaciones

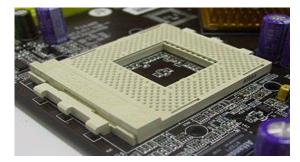




- 2.2.4. Componentes de la Placa Base
- 2.2.4.1 Socket del microprocesador

Es el zócalo donde se debe colocar el Procesador en la Placa Base.

- Socket PGA (Pin Gray Array): El socket de la placa base se compone de un conjunto de conectores o contactos y los pines están en el procesador. Normalmente este socket es utilizado por los procesadores AMD.







- Socket LGA (Land Grid Array): Los pines están en el socket de la placa base, y el Procesador tiene los contactos. Estos sockets son mucho más delicados ya que los pines son fáciles de doblar y obligaría cambiar la placa base.









2.2.4.2. Ranuras de memoria

- Conector de la Memoria RAM.
 - **DIMM 184 pines:** Módulo DDR (Double Data Rate).
 - **DIMM 240 pines:** Módulos DDR2 y DDR3.
 - DIMM 288 pines: Módulos DDR4 y DDR5.
 - DDR Doble Velocidad de Transmisión de Datos DIMM - Dual Inline Memory Module
- Se agrupan de 2 en 2 o de 4 en 4 para poder trabajar en Dual o Quad Channel.



- Módulos DRAM de tipo SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) para portátiles:
 - **SO-DIMM 200 pines:** Módulos DDR y DDR2.
 - SO-DIMM 204 pines: Módulos DDR3.
 - SO-DIMM 260 pines: Módulos DDR4.







DDR



DDR4-1

DDR2



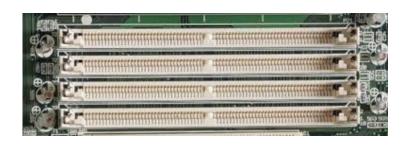
DDR3

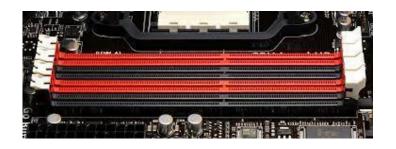


DDR4

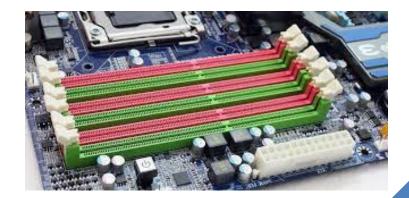














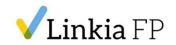


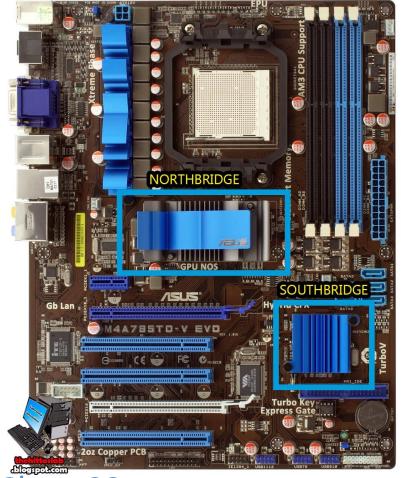
2.2.4.3. Conjunto de Chips - Chipset

- Conjunto de chips que ayudan a que el Procesador y los componentes del PC se comuniquen con los dispositivos conectados a la Placa Base y los controlen.
- Se identifican por el disipador.













- Funciones a realizar:
 - Controla la transmisión de datos, las instrucciones y las señales de control que van entre la CPU y la conexión con los controladores (SATA, PCI, USB), BIOS/EFI.
 - Maneja la **transferencia de datos** entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos.
 - Ofrece soporte para el bus de expansión.





2.2.4.4. Bios

- Basic Input Output System (Sistema Básico de Entrada y Salida).
- Controla y configura el hardware del sistema antes que el Sistema Operativo se haga con el control del equipo.
- Identifica los componentes conectados al equipo y pasar al Sistema Operativo su ubicación para que puedan comunicarse entre ellos.

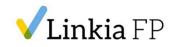


- El proceso de arranque (Boot):
 - **POST** (Power On Self Test): **Verifica** el estado del hardware. Orden de comprobación: Placa base, CPU, tarjeta gráfica, RAM, ranuras de expansión y unidades de almacenamiento.
 - Llamar al MBR (Master Boot Record): Acceder al gestor de arranque y seleccionar Sistema Operativo.
 - **GPT** (Tabla de Particiones GUID).
 - Llamar al Sistema Operativo.



- Principales fabricantes de BIOS:
 - Phoenix Technologies.
 - American Megatrends (AMI).
 - IBM.
 - Dell.
 - Gateway.
 - Byosoft.
 - Insyde Software.





CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2004, American Megatrends, Inc.

- Standard CMOS Features
- ▶ Advanced BIOS Features
- ► Advanced Chipset Features
- ▶ Integrated Peripherals
- ▶ Power Management Features
- ▶ PNP/PCI Configurations
- ▶ PC Health Status

► Cell_Menu

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

BIOS Setting Password

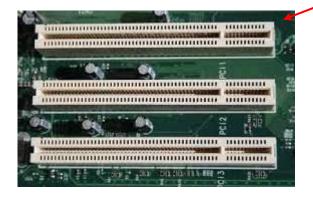
Save & Exit Setup

Exit Without Saving



2.2.4.5. Ranuras de expansión

- Tarjetas de expansión permiten ampliar las funcionalidades del equipo.
- Ranuras de expansión antiguas: PCI, AGP.
- Ranuras de expansión actuales: PCI-Express. (x4 y x1)





ASIX – M05 – Clase 02



2.2.4.8. Batería

- Pila de **3V** ubicada en la Placa Base.
- Proporciona energía para que almacenar información modificada de la **BIOS**.
- Cuando se agota la pila los valores de la BIOS se resetean.







2.3. CPU

- **Frecuencia** ("velocidad"): Número de transferencias por segundo que puede realizar la CPU, GHz.
- Arquitectura (número de bits del bus): 32 o 64 bits.
 - Memoria RAM direccionable 2^64 = 2.147.483.648 GB = 2048 PB → Limitación real a **192GB**.
 - Memoria RAM direccionable 2³² = **4GB**.
- Memoria Caché: Memoria integrada en la CPU.
- Número núcleos (cores): Ejecutar tareas a la vez.





- Voltaje: Recomendable que CPU utilice un voltaje pequeño => Se calentará y consumirá menos.
- **Disipación de calor** (TDP): Cantidad de calor que tiene que disipar la CPU. A menor TDP, más eficiente energéticamente será => Menor calentamiento => Menor sistema ventilación.
- Overclocking: Aumentar la frecuencia de la CPU. Podemos conseguir una potencia extra, pero es importante saber, que el procesador consumirá más energía y también generará más calor.



- **Sistemas de refrigeración:** Disipador, Ventilador, Sistema de refrigeración líquida, Heatpipes, etc.







2.4. Memoria RAM

2.4.1. Conceptos iniciales

- Memoria vs Dispositivos almacenamiento
- Memoria:
 - Memoria principal, memoria RAM.
 - Volátil.
 - Guarda datos y programas que hay en ejecución.
 - Mucho más rápida pero más pequeña.

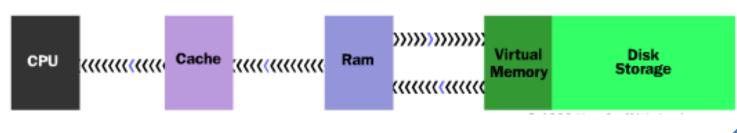




- Dispositivos de almacenamiento:
 - Memoria **secundaria**, auxiliar, memoria externa.
 - NO volátil.
 - Disco duro interno/externo, pen USB.
 - Mucho más lenta pero más grande.



Swap en Linux





- 2.4.2. Tipos de Memoria
- 2.4.2.2. DRAM Dynamic RAM
- Celdas eléctricas que necesitan refrescarse.
- En el proceso de refresco se vuelve a cargar eléctricamente cada una de las celdas.
- Cada celda: 1 transistor + 1 condensador.
- Ventaja => Precio económico.
- Inconveniente => 5 veces más lenta que la SRAM.
- Uso: Módulos de memoria RAM.



2.4.2.2. SDRAM – Synchronous DRAM

- Trabaja de forma síncrona con el Procesador.
- La CPU no debe entrar en estados de espera y el rendimiento que se consigue es superior.





2.4.3. Características de la Memoria

- Capacidad: Módulos de 4GB, 8GB, 16GB y 32GB.
- Frecuencia.
- **Tasa de transferencia**: A mayor frecuencia, mayor tasa de transferencia (bits/s).
- Latencia: Retardo que tenemos para acceder a los datos de memoria. Se mide en clocks.
 - CAS (Column Access Strobe) o CL (CAS Latency).
 - RAS (Row Access Strobe): clocks que se tardan en seleccionar la fila.



 Voltaje: Cuanto menor, mejor. Genera menos calor y consume menos.

SDRAM (3,3v), DDR (2,4-2,5v), DDR2 (1,8v) DDR3 (1,5v), DDR4 (**1,2v**)





2.5. Tarjetas Gráficas - GPU

- **GPU** Graphics Processor Unit, Procesador gráfico.
- Procesador dedicado a ejecutar operaciones a mostrar por pantalla.
- Su función principal es **liberar a la CPU** de la carga de trabajo relacionada con los elementos gráficos.
- Fabricantes destacados: nVidia.
- Característica principal: Frecuencia, medida en GHz.

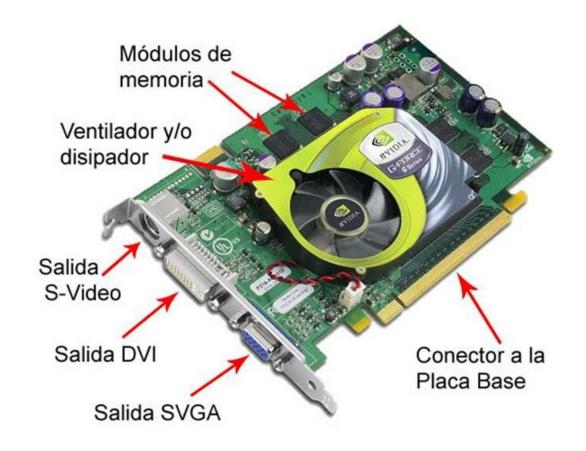












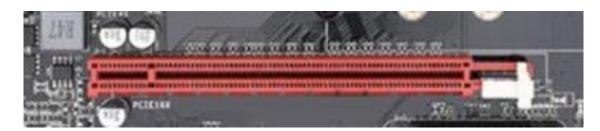


2.5. Tarjetas Gráficas - VRAM - Vídeo RAM

- Memoria RAM dedicada exclusivamente a guardar los cálculos que hace la GPU.
- Tecnología GDDR: Graphics DDR. GDDR6X.
- Frame Buffer: Área de la VRAM donde hay mapeadas las imágenes que se verán por pantalla.
- Shared Memory: Memoria RAM del sistema que está compartida con la tarjeta gráfica.



- PCle de 16X









2.6. Tarjetas de Expansión

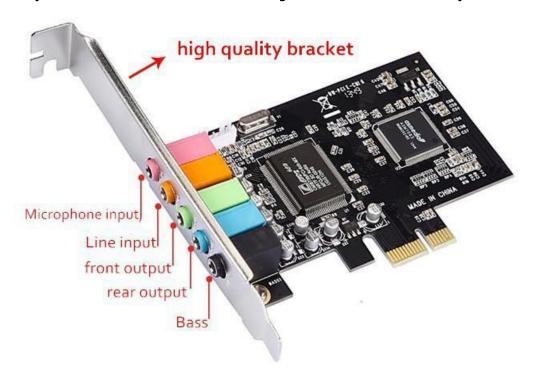
- Tarjetas de red: Más común las WIFI, ya que las Placas Base incorporan conexión cableada (Ethernet) con un conector RJ-45.







- **Tarjetas de sonido:** Normalmente ya incorporan. Se puede ampliar con una tarjeta de uso profesional.



ASIX – M05 – Clase 02



- Tarjeta captura de televisión: Ver TV, grabar en directo, memorizar y sintonizar canales, etc.
- Tarjeta RAID: Se utiliza en Servers. Permite configurar discos duros redundantes y de esa forma se añade seguridad al sistema y accesibilidad a los datos.
- Tarjeta ampliadora USB: Todas las placas base incorporan puertos USB, pero en diversas ocasiones es imprescindible más puertos USB, o de más velocidad.



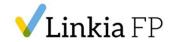


2.7. Unidades de Almacenamiento

- HDD (Hard Disk Drive)
 - Unidad de almacenamiento secundaria: no volátil.
 - Se instala el Sistema Operativo.
 - Donde se instalan los programas.
 - Se guardan la mayoría de se datos.



CHI.







Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY





- Plato/Disco: Almacena la información de forma magnética. Los discos pueden tener 2 o más platos. En el caso que el disco tenga más de 1 plato, todos girarán a la vez.







2.7. Unidades de Almacenamiento

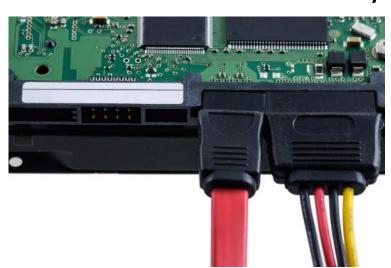
- SSD (Solid State Drive) Unidad de Estado sólido.
 - Menor consumo y menor emisión de calor.
 - No tiene cabezales, ni discos ...
 - Incorporan chips, haciendo que sea totalmente electrónico y nada mecánico.
 - Mucho más rápidos, sencillos y seguro.
 - Se reduce mucho el tiempo de búsqueda en general.
 - Silencioso.





2.7.4. Interfaz de conexión de los discos sólidos

- **SSD de 2,5":** Se conectan al SATA (Serial ATA) 3, tasa de transferencia de 6Gb/s.









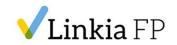
- **Formato M.2:** Se conecta al M.2 en modo SATA con velocidades similares SATA SSD convencional (600MB/s) o PCI-e (tasas de lectura hasta 3500MB/s). Menor peso y tamaño.







- Formato de tarjeta de expansión o los NVMe: Se conectan directamente a una ranura PCI-e. Las tasas de transferencia son mucho mayores.
- NVMe o Non-Volatile Memory Express: Interfaz de almacenamiento introducida en 2013. Los datos almacenados en la memoria no se borran cuando el PC se apaga. Express está asociado al hecho de que los datos viajan a través de una interfaz PCI Express (PCIe).













Tipos de interfaces:

- IDE (Intelligent Drive Electronics)/Parallel ATA (Advanced Technology Attachment)



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

- SCSI (Small Computer System Interface):



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND



Placa Base para el apartado 2.2. de la Actividad 1: Gigabyte Z490 GAMING X AX







Placa Base para el apartado 2.3. de la Actividad 1:

ASUS PRIME Z390-A

Placa Base para el apartado 4.3. de la Actividad 1:

Tiempo de Acceso = (Latencia / Frecuencia) x 2 x 1024

Tiempo de Acceso en nanosegundos nsg Latencia en CL y Frecuencia en MHz



Formación Profesional Oficial a Distancia